



研究方向

中心简介

中心动态

科研团队

研究方向

研究成果

人才培养

招聘

联系我们

研究方向

您的位置: 首页 > 研究方向

高集成信息光电子器件与芯片

发布时间: 2021-01-06 阅读次数: 0

工程中心研制了硅激光器阵列、硅基高速调制器阵列、硅基MUX、DEMUX、路由器和硅基锗探测器阵列,初步探索了基于CMOS技术的硅光芯片上的多功能器件集成技术,研制了硅基混合集成宽带高速光访问芯片;基于光子态电子态联合调控新原理新方案,发展了光子晶体半导体激光的全套具有自主知识产权的技术体系,应用光子晶体激光器开发的激光微推进器系统将于年底在微小卫星上完成搭载功能验证。

工程中心主要对高质量的半导体外延材料和单晶的研制,针对国家“十三五”期间“大力发展磷化铟、碳化硅等下一代半导体材料”的战略需求,突破高纯红磷、高纯铟

备案号:

高质量半导体外延材料及单晶